



# THP-100 Series

## 熱硬化型穴埋めインキ

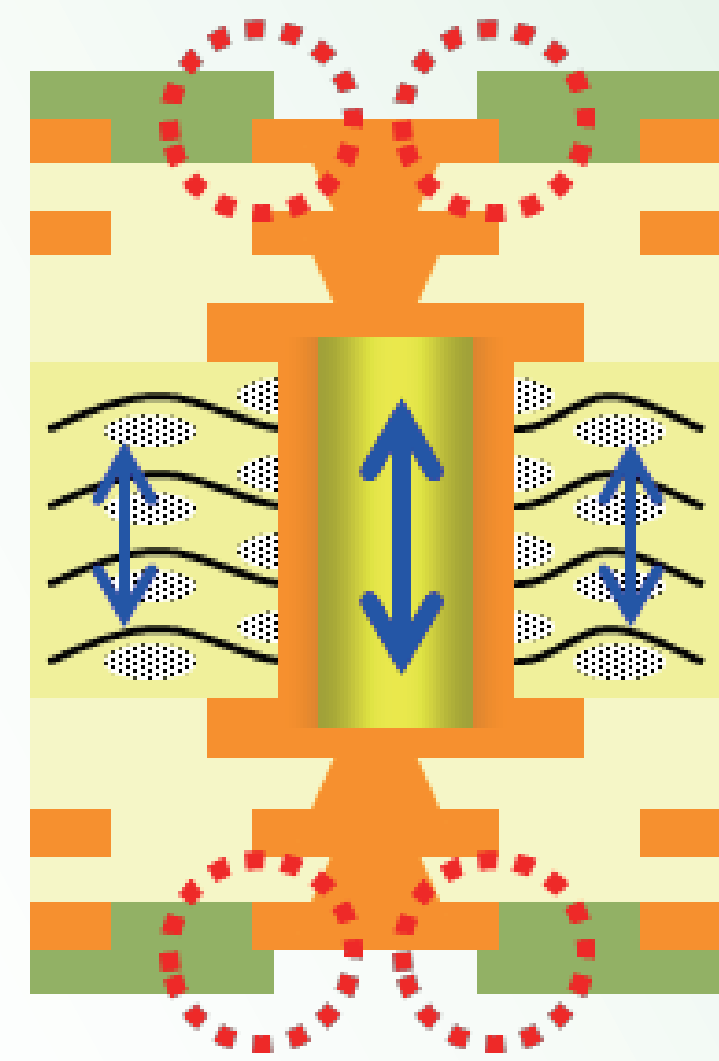
Thermal Curable Permanent Hole-Plugging Materials

### 特長 Features

#### THP-100 DX7

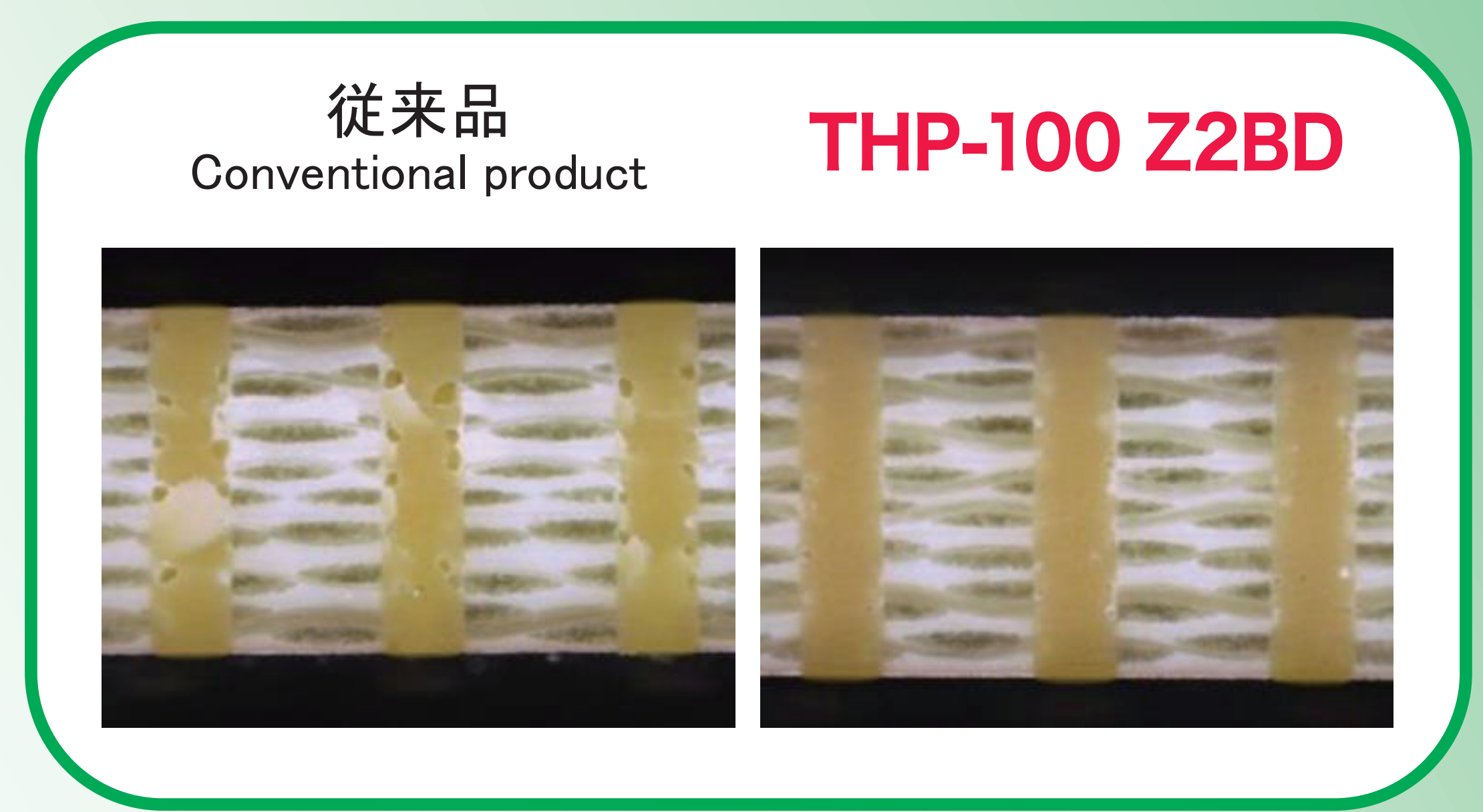
- 高Tg / 低CTE High Tg / Low CTE
- 高信頼性 High reliability  
-65°C⇔150°C、1000Cycleクラックなし  
リフロー耐性良好

	従来品 Conventional product	THP-100 DX7
Before Reflow		
L2a (C-120/60/60)+ Reflow (270°C/5cycles)		



#### THP-100 Z2BD

- バックドリル対応 For Back-drill type
- 保存安定性良好 Very long pot life
- アウトガスによるボイド低減  
Excellent for void due to outgas



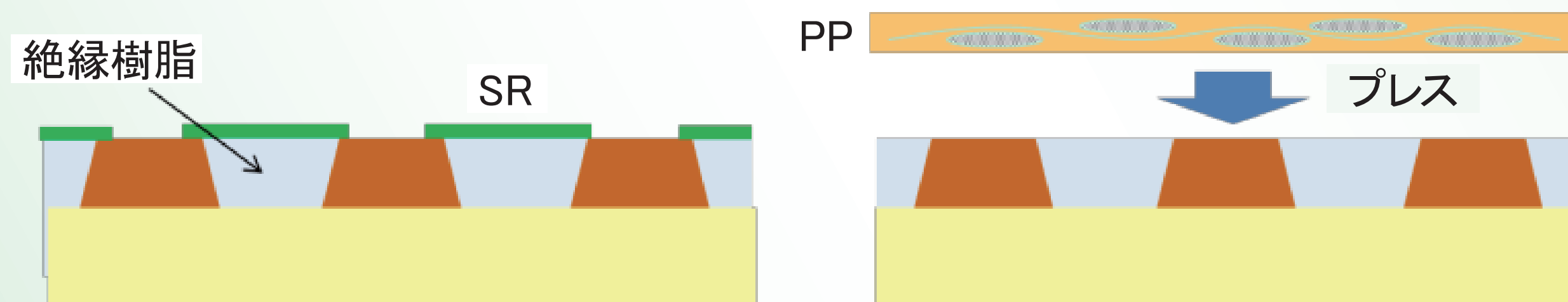
## ギャップ埋めインキ

Thermal Curable Gap Filling Material

### 特長 Features

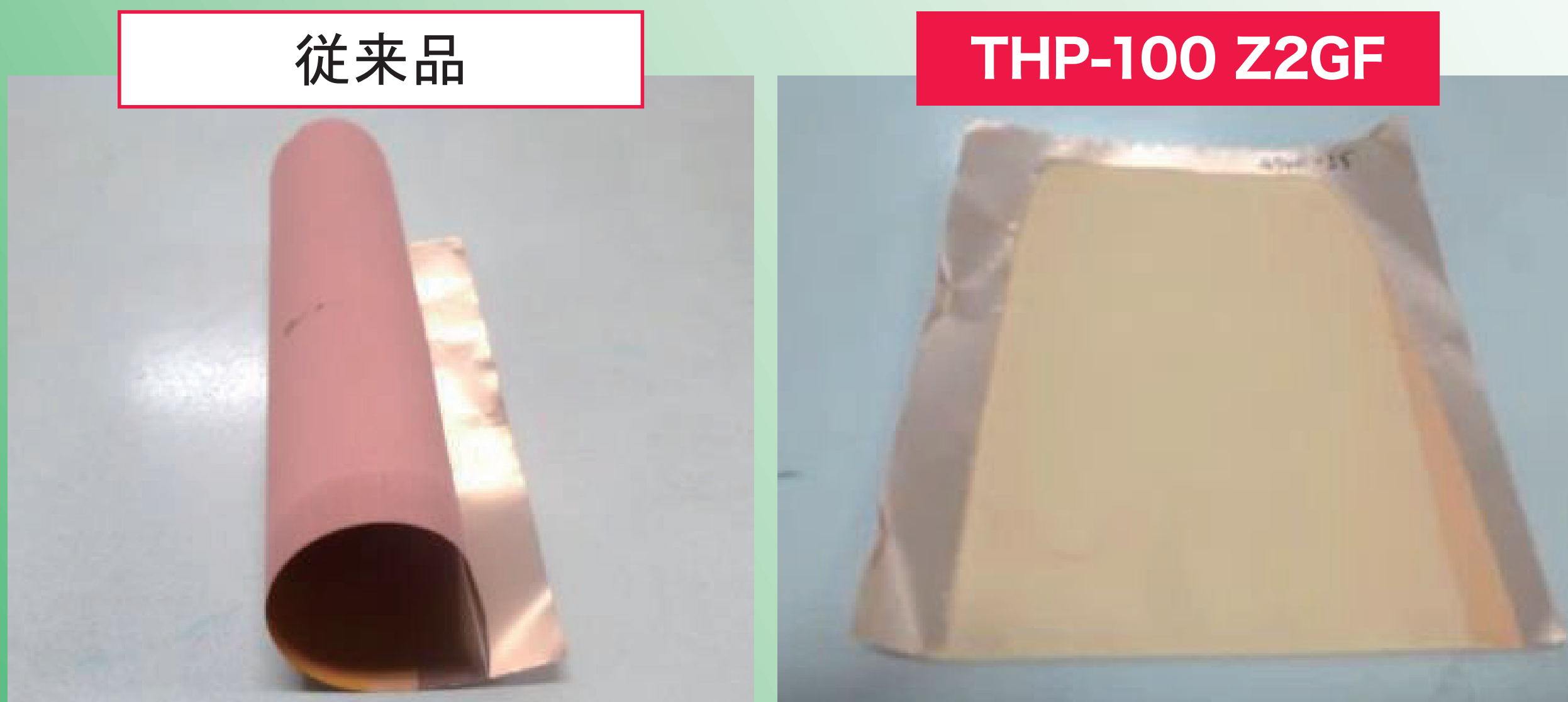
#### THP-100 Z2GF

- 回路厚の厚い基板に対して回路間にギャップ埋めインキを充填して平坦化することができます  
Gap filling material can be used to fill high copper circuits for planner layer.

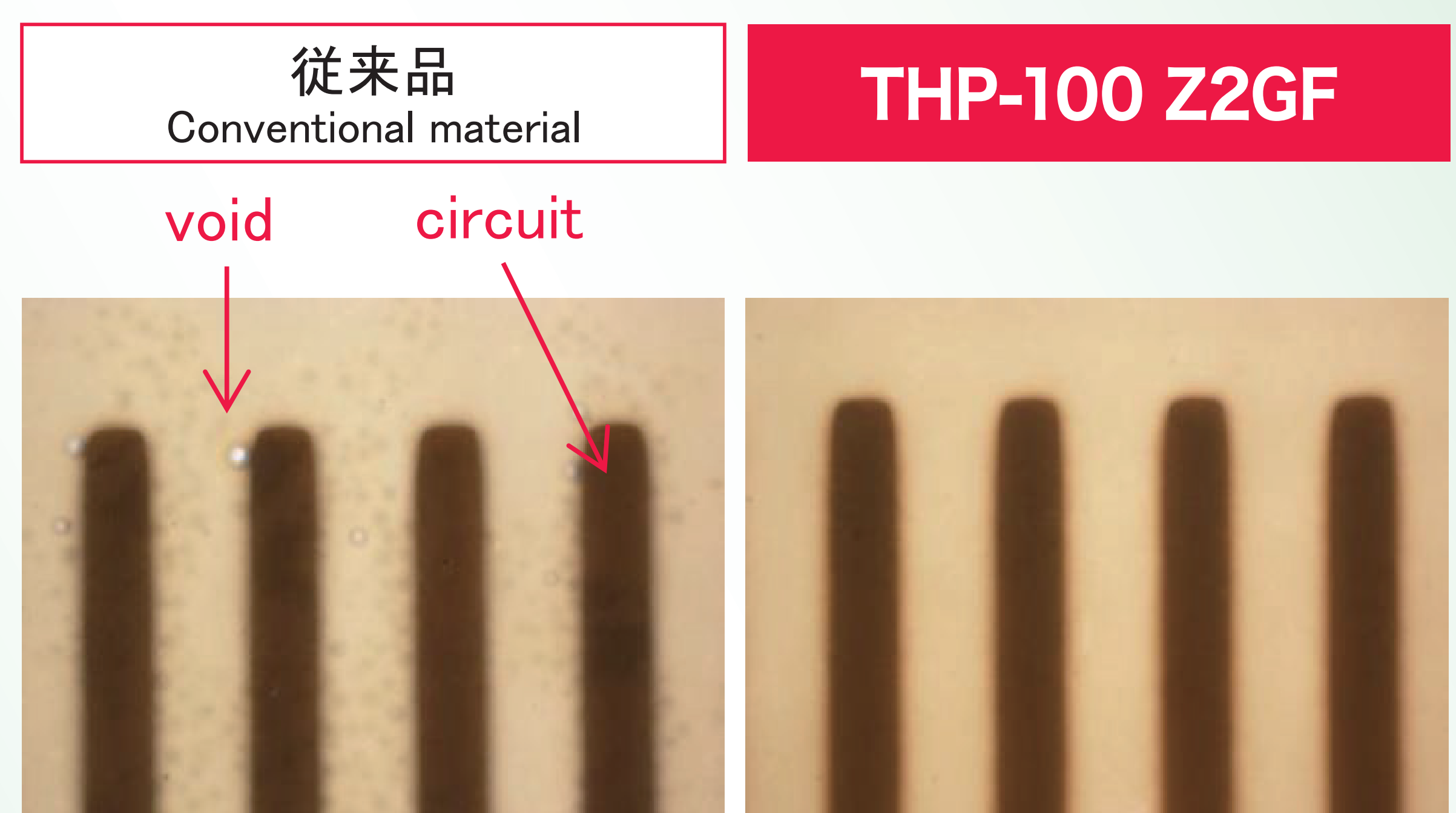


回路間に絶縁樹脂を充填し平坦化する → SR印刷やPP積層が容易になる

- 低反り Low warpage



- 大気印刷においてもボイドフリー Void free



TAIYO INK MFG. CO., LTD.